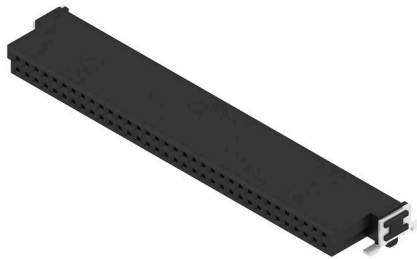


제품 이미지



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 68, 90°, Tape
주문 번호	2747500000
유형	FFH S1/68H F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000860
수량	560 items
제품 데이터	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
패키징	Tape

FFH S1/68H F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	10.9 mm	깊이 (인치)	0.4291 inch
높이	3.7 mm	높이 (인치)	0.1457 inch
너비	48.26 mm	폭 (인치)	1.9 inch
순중량	5.54 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

전송 속도	3.125 Gbit/s	제품군	OMNIMATE 신호 - 보드 투 보드
결선 유형	보드 결선	PCB에 장착	SMD 용접 결선
피치(mm)(P)	1.27 mm	피치(인치)(P)	0.050 "
외향 앵글	90°	극 수	68
플랫 용접 핀 수	1	공면:	0.1 mm
행 수	1	핀 시리즈 수량	2
보호 등급	IP20	볼륨 저항	<25 mΩ
플러그 주기	500	플러깅 힘/폴, 최대	0.6 N
당기는 힘 / 폴, 최대	0.6 N		

자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	IIIa
절연 저항	≥ 10 ¹⁰ Ω	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 기본 재질	구리 합금
접점 재질	구리 합금	접점 표면	금 도금 니켈
플러그 접점의 레이어 구조	≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-55 °C
작동 온도, 최대	125 °C		

IEC 정격데이터

정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	2.8 A	연면거리, 분	0.4 mm
최소간격, 분	0.4 mm		

UL 1977에 따른 정격 데이터

승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조	정격 전압(UL 1977)(구형)	150 V
--------	------------------------	--------------------	-------

기술 데이터

패키징

패키징	Tape	VPE 길이	350.00 mm
VPE 폭	340.00 mm	VPE 높이	135.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

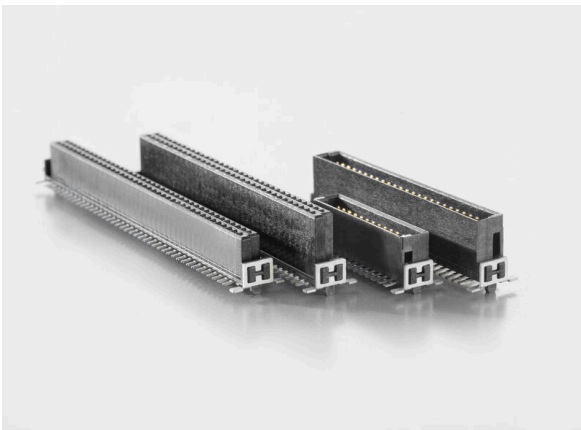
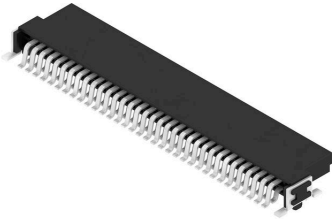
참고 사항

분류

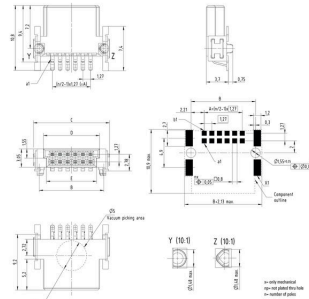
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

도면

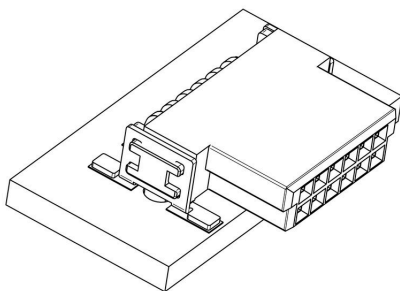
제품 이미지



Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E
FFH S1/68H F1 B RL	2747430000	12	6.35	10.27	12.7	5.37	8.37
FFH S1/68H F1 B RL	2747430001	16	8.89	13.31	15.24	11.81	10.81
FFH S1/68H F1 B RL	2747430002	20	11.43	15.85	17.78	14.45	13.45
FFH S1/68H F1 B RL	2747430003	25	13.97	18.39	21.29	16.99	17.29
FFH S1/68H F1 B RL	2747430004	30	16.51	20.93	24.14	22.57	21.57
FFH S1/68H F1 B RL	2747430005	40	21.43	28.81	32.49	31.53	28.53
FFH S1/68H F1 B RL	2747430006	50	26.35	36.69	39.53	39.53	35.53
FFH S1/68H F1 B RL	2747430007	60	31.27	44.57	46.20	44.93	42.93
FFH S1/68H F1 B RL	2747430008	80	41.15	58.45	60.88	52.55	51.55



상세 도면



감소 곡선





FFH S1/68H F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

FMH - 수형 헤더, 보드 결선



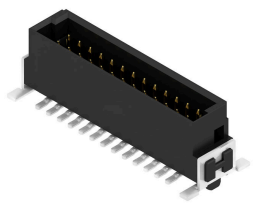
OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
 컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
 미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고점점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH S1/68H F1 B RL	버전	
주문 번호	2747230000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27	
GTIN (EAN)	4064675001027	mm, 극 수: 68, 90°, Tape	
수량	560 ST		

FMH1 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 1.75mm)



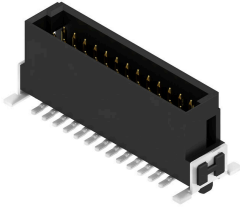
OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
 컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
 미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고점점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH1 S1/68V F1 B RL	버전	
주문 번호	2747050000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27	
GTIN (EAN)	4064675001188	mm, 극 수: 68, 180°, Tape	
수량	280 ST		

FMH3 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 3.25mm)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH3 S1/68V F1 B RL	버전	
주문 번호	2747140000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27	
GTIN (EAN)	4064675001201	mm, 극 수: 68, 180°, Tape	
수량	280 ST		